

光电子学

微通道板电子透射膜工艺的AES研究

闫金良

(烟台师范学院物理系, 山东烟台 264025)

收稿日期 2003-6-25 修回日期 网络版发布日期 2006-9-4 接受日期

摘要 用冷基底溅射方法和静电贴膜方法分别在微通道板表面制备了电子透射膜, 采用俄歇电子能谱(AES)研究了两种工艺制备的微通道板电子透射膜的薄膜成分, 微通道板电子透射膜工艺失败微通道板通道表面的成分和通道内壁的成分随深度的变化. 结果表明, 冷基底溅射方法制膜工艺的失败对MCP造成了严重的碳污染, 污染的MCP不可回收; 静电贴膜方法制膜工艺的失败对MCP通道表面没有明显影响, MCP可回收利用.

关键词 [微通道板](#) [电子透射膜](#) [像增强器](#) [碳污染](#)

分类号 [TN105.1](#) [TN223](#)

通讯作者 闫金良 chanhuoyan@163.net

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(582KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ 本刊中 [包含“微通道板”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
- [闫金良](#)